

ТВЕРДОТЕЛЬНАЯ СВЧ-МИКРОЭЛЕКТРОНИКА

- | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>5. Temperature measurement and control / Product Catalog and Reference Guide. Part 1.— Westerville, Ohio (USA): Published by Lake Shore Cryotronics, Inc.— 1999.</p> <p>6. Shwarts Yu. M., Borblik V. L., Kulish N. R. et al. Silicon diode temperature sensor without a kink of the response curve in cryogenic temperature region // Sensors and Actuators.— 1999.— Vol. A76 (1–3).— P. 107—111.</p> <p>7. Shwarts Yu. M., Sokolov V. N., Shwarts M. M. et al. Silicon diode temperature sensor for cryogenic application / The MTEC Conf. on Sensors and Transducers NEC.— Birmingham (UK).— 2000.— P. 1—10.</p> <p>8. Shwarts Yu. M., Kondrachuk A. V., Shwarts M. M., Spinar L. I. Non-ohmic Mott conductivity and thermometric characteristics of heavily doped silicon structures // Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics.— 2000.— Vol. 3, N 3.— P. 400—405.</p> | <p>9. Shwarts Yu. M., Borblik V. L., Kulish N. R. et al. Limiting characteristics of diode temperature sensor // Sensors and Actuators.— 2000.— Vol. A86.— P. 197—205.</p> <p>10. Shwarts Yu. M., Kondrachuk A. V., Shwarts M. M., Spinar L. I. Model of the low-temperature current transfer in the diode temperature sensors / 4th European Workshop on Low Temperature Electronics.— 2000.— Noordwijk (The Netherlands).— P. 65—69.</p> <p>11. Shwarts Yu. M., Sokolov V. N., Shwarts M. M., Venger E. F. Temperature sensors with high irradiation resistance for atomic application (technology, design, experiment, theory, application) / 11th International Conf. on Solid-State Sensors and Actuators.— 2001.— Munich (Germany).— P. 1500—1503.</p> <p>12. Shwarts Yu. M., Sokolov V. N., Shwarts M. M., Venger E. F. Radiation resistant silicon diode temperature sensors // Sensors and Actuators.— 2002.— Vol. A88.— P. 271—279.</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

К. т. н. В. А. МОСКАЛЮК, к. т. н. В. И. ТИМОФЕЕВ, А. В. ИВАЩУК

Дата поступления в редакцию
04.04.2003 г.

Украина, г. Киев, Научно-производственное предприятие "Сатурн"
E-mail: ivaschuk@i.com.ua

Оппонент д. ф.-м. н. В. Е. ЧАЙКА
(НТУУ "КПИ", г. Киев)

РАСЧЕТ РЕЛАКСАЦИОННЫХ ПАРАМЕТРОВ GaAs В СИЛЬНЫХ ПОЛЯХ

Предложен способ аналитического расчета времен релаксации концентрации, импульса и энергии для GaAs для моделирования динамических процессов.

Анализ динамических свойств электронов в сильных электрических полях удобно проводить на основе так называемых релаксационных уравнений сохранения числа частиц n_i , их импульса $P=mV$ и энергии E для i -долины:

$$dn_i/dt = -n_i/\tau_{nij} + n_j/\tau_{nji}; \quad (1, a)$$

$$d(n_i p_i)/dt - e n_i \mathbf{v} \cdot \boldsymbol{\epsilon} = -n_i p_i/\tau_{pi}; \quad (1, b)$$

$$d(n_i E_i)/dt - e n_i \mathbf{v} \cdot \boldsymbol{\epsilon} = -n_i (E_i - E_0)/\tau_{Ei}. \quad (1, c)$$

Вместо последнего уравнения для полной энергии E удобнее пользоваться уравнением только для тепловой энергии хаотического движения:

$$d(n_i E_{ti})/dt = -n_i [(E_{ti} - E_0)/\tau_{Ei} + E_{di}/\tau_{Ei} - 2E_{di}/\tau_{pi}], \quad (1, d)$$

которое определяет электронную температуру. Входящие сюда времена релаксации концентрации τ_{nij} , импульса τ_{pi} и энергии τ_{Ei} определяют скорости протекания переходных процессов в электронном коллективе и обычно находятся из результатов моделирования методом Монте-Карло (что весьма трудоемко), либо из различного рода эмпирических соотношений, что неточно.

В данной работе предлагается простой способ аналитического их определения. Так как они по своей сути являются характеристиками, усредненными по всей совокупности параметров носителей, то *среднее время релаксации импульса* находится усреднением известных [1] скоростей рассеяния λ для различных механизмов по функции распределения электронов. Функцию распределения $N(E)=g(E)\cdot f(E)$ выбираем максвелловской ($f(E)=\exp[-(E_\phi - E)/(k_B T_e)]$),

в которой для учета неравновесности вместо температуры решетки T используется электронная температура T_e . На основе соотношения $N(k)dV_k=N(E)dE$ при квадратичном законе дисперсии производится переход от интегрирования по пространству импульсов к интегрированию по энергии. Опуская формальные процедуры интегрирования, приведем лишь окончательные результаты.

Примесное рассеяние является практически упругим и эффективно хаотизирует движение, внося существенный вклад в релаксацию импульса. Для времени релаксации импульса можно использовать модель Брукса—Херринга, учитывающую экранирование примесного центра носителями:

$$\frac{1}{\tau_{ppr}} = \sqrt{\frac{8\pi}{m^*}} \left(\frac{e^2}{4\pi\epsilon\epsilon_0} \right)^2 \left[\ln(1+\eta) - \frac{\eta}{1+\eta} \right] N_{ppr} (k_B T_e)^{-3/2}, \quad (2)$$

где $\eta=(2kr_3)^2=12\epsilon\epsilon_0 m^* (k_B T_e)^2 / \hbar^2 e^2 N_{ppr}$.

Для *акустического рассеяния* характерна линейная зависимость скорости рассеяния от температуры кристаллической решетки T , что связано с уменьшением длины свободного пробега при увеличении количества фононов, и от скорости носителей, пропорциональной $E^{1/2}$. При усреднении по максвелловской функции распределения время релаксации импульса будет совпадать со скоростью акустического рассеяния при замене $E = 3k_B T_e/2$:

$$\frac{1}{\tau_{pak}} = \frac{\sqrt{3} m^{*3/2} D_a^2}{\pi \hbar^4 \rho v_{3B}^2} k_B T \sqrt{k_B T_e}. \quad (3)$$

Оптическое рассеяние является неупругим, при каждом взаимодействии такого рода энергия электрона изменяется на величину $\pm \hbar\omega_0$. Так как эта величина оптического фонона может быть соизмерима с энергией носителей, то скорости рассеяния с погло-

ТВЕРДОТЕЛЬНАЯ СВЧ-МИКРОЭЛЕКТРОНИКА

щением фона и с его возбуждением могут заметно различаться. Усреднение скоростей рассеяния на *оптическом деформационном потенциале* дает для времен релаксации импульса выражение

$$\frac{1}{\tau_{po}^{\pm}} = \left(\frac{m^*}{2\pi} \right)^{3/2} \frac{D_0^2}{\rho \hbar^2} \frac{e^{\mp(t-t_e)}}{(k_B T_e)^{1/2} \operatorname{sht}} K_1(t_e). \quad (4)$$

Здесь $t_e = \hbar \omega_0 / 2k_B T_e$, $t = \hbar \omega_0 / 2k_B T$, а K_1 — модифицированная функция Бесселя второго рода первого порядка.

Общее время релаксации импульса находится через сумму обратных времен для поглощения и возбуждения:

$$\frac{1}{\tau_{po}} = 2 \left(\frac{m^*}{2\pi} \right)^{3/2} \frac{D_0^2}{\rho \hbar^2} \frac{\operatorname{ch}(t-t_e)}{(k_B T_e)^{1/2} \operatorname{sht}} K_1(t_e). \quad (5)$$

Для *полярного оптического рассеяния* усреднение скорости рассеяния дает подобные результаты, отличающиеся коэффициентом и на единицу меньшим порядком функции Бесселя:

для обратных времен при поглощении и излучении

$$\frac{1}{\tau_{ppo}^{\pm}} = \frac{\alpha \omega_0 t_e^{1/2}}{\sqrt{2\pi} \operatorname{sht}} \exp[\mp(t-t_e)] \cdot K_0(t_e) \quad (6)$$

и для суммарного времени

$$\frac{1}{\tau_{ppo}} = \alpha \omega_0 \sqrt{\frac{2}{\pi}} \cdot \frac{\operatorname{ch}(t-t_e)}{\operatorname{sht}} t_e^{1/2} K_0(t_e), \quad (7)$$

где введена так называемая *полярная константа*

$$\alpha = \frac{e^2 \sqrt{m^*}}{4\sqrt{2\pi} \epsilon \hbar (\hbar \omega_0)^{1/2}} \left(\frac{1}{\epsilon_{\infty}} - \frac{1}{\epsilon_{ct}} \right). \quad (8)$$

Междолинное рассеяние также является неупругим, поскольку в каждом акте рассеяния поглощается или излучается *междолинный фонон* с энергией $\hbar \omega_{ij}$, близкой к энергии оптических фононов. При рассмотрении междолинного рассеяния, в отличие от других механизмов, усреднение кинетического уравнения производится не по всей зоне Бриллюэна, а по характерным состояниям, соответствующим отдельным долинам. Поэтому даже при сохранении общего количества частиц во всей зоне их концентрация может перераспределяться между отдельными долинами. Соответственно инерционность этого процесса определяется концентрационным временем релаксации τ_n , которое находится, как и время релаксации импульса τ_p , усреднением скорости междолинного рассеяния. Используя для этого, как и в предыдущих случаях, максвелловскую функцию с электронной температурой T_e , получим для времен релаксации τ_{pp}^{\pm} с поглощением (верхний знак) и испусканием (нижний знак) междолинного фонона $\hbar \omega_{ij}$ при переходе электрона из i -долины в j -долину:

$$\frac{1}{\tau_{ppj}^{\pm}} = \left(\frac{m_j^*}{2\pi} \right)^{3/2} \frac{Z_j D_{ij}^2}{\rho \hbar^3 \omega_{ij}} \frac{e^{-\delta_{ij}/2}}{\operatorname{sht}} |\delta_{ij}| \sqrt{k_B T_e} e^{\mp(t-t_e)} K_1(|\delta_{ij}|/2) \quad (9)$$

Здесь $\delta_{ij} = \Delta_{ij}/k_B T_e = (E_{cj} - E_{ci})/k_B T_e$ — нормированное расстояние от дна j -долины до дна i -долины, т. е. при переходе электрона из нижней долины в верхнюю $\delta_{ij} > 0$, а величины t и t_e определяются как и при оптическом рассеянии, но в них нужно подставлять энергию *междолинного* фонона.

Суммирование обратных времен релаксации с излучением и поглощением фононов дает

$$\frac{1}{\tau_{ppj}} = \left(\frac{m_j^*}{2\pi} \right)^{3/2} \frac{2 Z_j D_{ij}^2}{\rho \hbar^3 \omega_{ij}} \frac{|\delta_{ij}| e^{-\delta_{ij}/2}}{\operatorname{sht}} \operatorname{ch}(t-t_e) \sqrt{k_B T_e} K_1(|\delta_{ij}|/2) \quad (10)$$

При использовании последних соотношений нужно обратить внимание на следующие обстоятельства. Во-первых, в эти соотношения входит эффективная масса плотности состояний, которая обычно учитывает количество долин, и в таком случае величину Z_j нужно исключить. Во-вторых, выражения (9) и (10) получены в предположении, что энергия междолинного фонона намного меньше междолинного расстояния ($\hbar \omega_{ij} \ll \Delta_{ij}$). Это вполне оправдано для большинства практических важных случаев, когда междолинное расстояние заметно превышает величину $k_B T$. Для анализа рассеяния между эквивалентными долинами ($\Delta_{ij} = 0$) можно использовать соотношения (4) и (5) для времен релаксации при неполярном оптическом рассеянии с соответствующей заменой обозначений.

Взаимодействие электрона с примесными атомами является практически полностью упругим и не вызывает релаксации энергии. Поэтому считают, что для *примесного рассеяния* $1/\tau_{E_{pp}} = 0$.

При определении времен релаксации энергии для *фононных видов* рассеяния удобнее пользоваться не временем τ_E , а отношением

$$\frac{\tau_p}{\tau_E} = \frac{\hbar \omega_{\phi}}{E - E_0} \frac{1/\tau_{p\phi}^+ - 1/\tau_{p\phi}^-}{1/\tau_{p\phi}^+ + 1/\tau_{p\phi}^-}, \quad (11)$$

которое характеризует среднюю часть энергии, теряемой электроном за время τ_p , т. е. степень упругости соударений. При подстановке выражений для оптических видов рассеяния отношение примет вид

$$\frac{\tau_p}{\tau_E} = \frac{4}{3} \frac{t_e}{t - t_e} \operatorname{th}(t - t_e). \quad (12)$$

При междолинном рассеянии, когда энергия электрона изменяется не только на величину энергии фонона, но и на величину междолинного расстояния $\pm \Delta_{ij}$, аргументом функции Бесселя является параметр $|\delta_{ij}/2 \pm t_e|$, и соответствующее выражение будет более сложным. Однако для наиболее типичных случаев, когда $\hbar \omega_{ij} \ll \Delta_{ij}$, отношение τ_p/τ_E также можно определять по (12).

Важным свойством отношения времен релаксации импульса и энергии является практически линейная зависимость от обратной электронной температуры, что предопределяет специфику протекания физических процессов в сильных электрических полях. Однако это характерно только для *оптических и меж-*

ТВЕРДОТЕЛЬНАЯ СВЧ-МИКРОЭЛЕКТРОНИКА

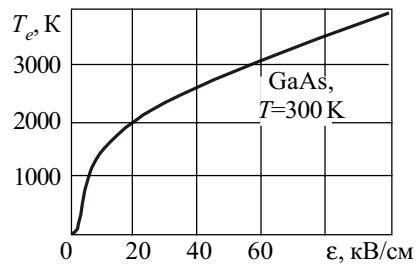
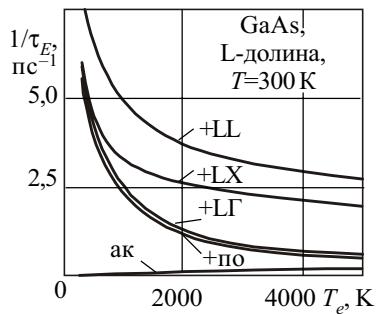
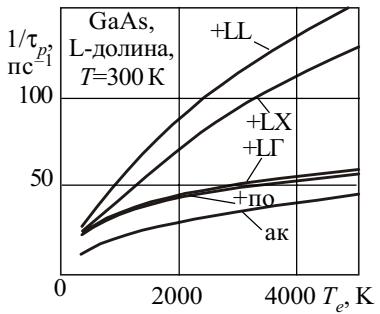
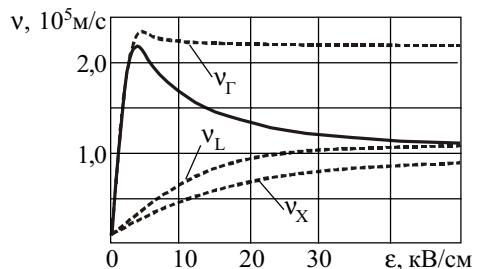
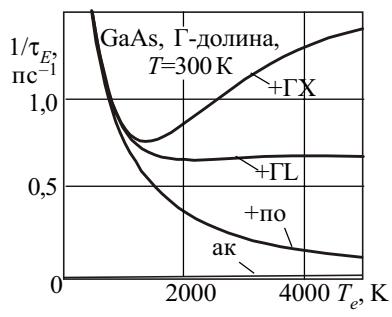
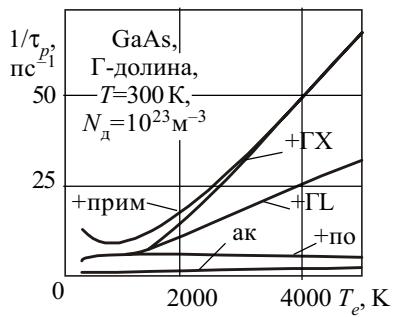


Рис. 1

Рис. 2

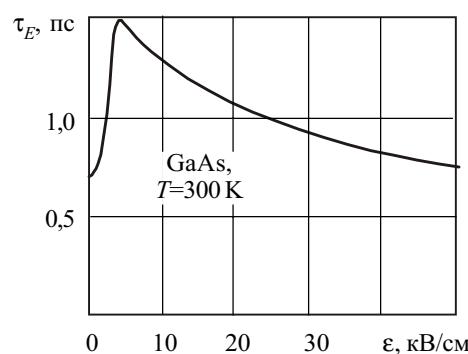
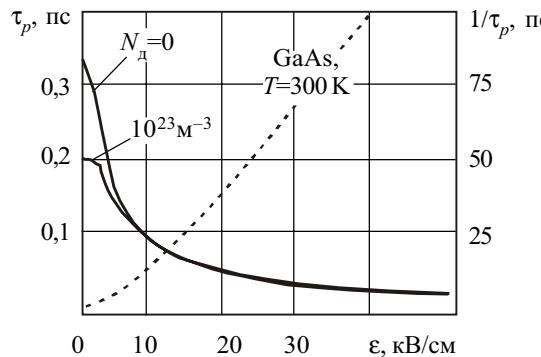


Рис. 3

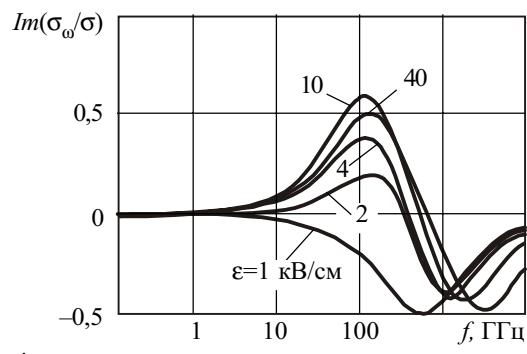
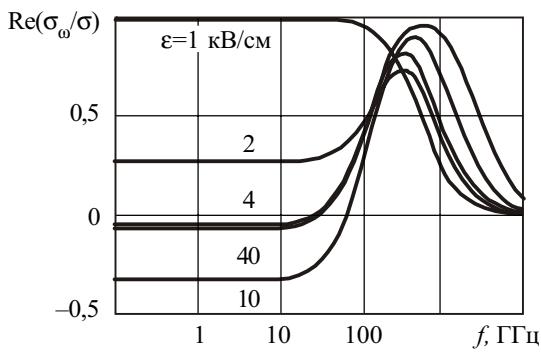


Рис. 4

долинных фононов, энергия которых из-за узости спектра принимается постоянной.

При участии в рассеянии акустических фононов наблюдается несколько иная ситуация. Во-первых, из-за их малой энергии и, соответственно, высокой упругости этого рассеяния иногда пренебрегают акустическим механизмом релаксации энергии. Но при отсутствии оптического рассеяния именно акустический механизм вызывает передачу энергии от элект-

ронов кристаллической решетке. Во-вторых, упругость акустического рассеяния практически не зависит от электронной температуры, т. к. с ростом T_e возрастает и энергия фононов, участвующих в рассеянии. Эта особенность связана с тем, что спектр акустических колебаний достаточно широкий и в рассеянии принимают участие лишь низкочастотные фононы. При квадратичном законе дисперсии электронов и линейном для фононов [2] отношении (11) принимает вид

$$\frac{\tau_p}{\tau_E} = \frac{4m^* v_{3B}^2}{k_B T}. \quad (13)$$

На **рис. 1** представлены результаты расчета обратных времен релаксации импульса и энергии для различных видов рассеяния для L- и X-долин в зависимости от электронной температуры. Используя их значения, на основе уравнений (1) суммированием вкладов электронов каждой долины [3] могут быть найдены стационарные поле-скоростная $v(\mathbf{E})$ и поле-температурная $T_e(\mathbf{E})$ характеристики (**рис. 2**), а также относительные заселенности долин n_i/n .

Графики этих функций хорошо соответствуют широко известным данным эксперимента для GaAs и из них могут быть вычислены средние по долинам времена релаксации, которые представлены на **рис. 3** и которые могут использоваться для анализа релаксационных процессов на основе уравнений, подобных (1), но без разделения по долинам.

Полученные релаксационные параметры хорошо описывают и высокочастотные свойства GaAs. Величина высокочастотной электропроводности, нормированная на ее статическое значение, может быть рассчитана в малосигнальном приближении из соотношения [4]

$$\frac{\sigma_\omega}{\sigma} = \frac{\tau_{p\omega}}{\tau_{p0}} - \frac{v_{0\Gamma}}{v_{n\Gamma}} \frac{\tau_{E\omega}}{\tau_{E0}} \left(\frac{\tau_{p\omega}}{\tau_{p0}} + \frac{b_{ij} b_{j0}}{1+i\omega\tau_m} \frac{\Delta_{ji}}{k_B T_e} \right) \quad (14)$$

где $\tau_m = (1/\tau_{ij} + 1/\tau_{ji})^{-1}$ — суммарное для всех долин время междолинной релаксации.

На **рис. 4** представлены частотные зависимости действительной и мнимой частей электропроводности, нормированной на ее статическое значение $\sigma = e^2 n \tau_{p0}/m^*$. Частотная зависимость σ_ω определяется множителями $\tau_\omega/\tau_0 (1+i\omega\tau)^{-1}$, содержащими три временные константы — τ_p , τ_E и τ_m . Первое слагаемое зависит от частоты столкновений, т. е. от времени релаксации импульса, и объясняется инерционностью процессов рассеяния. Второе слагаемое связано с переходом дрейфовой скорости к режиму насыщения, что требует участия оптических фононов и возможно только при повышении температуры электронов. Инерционность процессов разогрева определяется временем релаксации энергии, поэтому второе слагаемое содержит еще и τ_E . Для процессов, связанных с перераспределением электронов по долинам, характерна инерционность как процессов разогрева, так и междолинных переходов. Поэтому в третье слагаемое входят времена τ_E и τ_m . Здесь τ_m — время междолинной релаксации, обратная величина которого находится суммированием обратных времен τ_{nij} для разных долин. Существенно также, что оно пропорционально энергетическому расстоянию Δ_{ij} между долинами и предопределяет отрицательные значение σ_ω (ОДП).

Из этих трех времен наибольшее значение (около 1 пс) имеет время τ_E , поэтому верхний частотный предел ОДП зависит прежде всего от инерционности процессов разогрева электронов и составляет десятки гигагерц. В слабом поле (верхняя кривая на **рис. 4**) процессы разогрева и междолинных переходов не существенны, поэтому спад проводимости определяется величиной τ_p и происходит на частоте около 100 ГГц. Реактивная проводимость проявляется на более низких частотах (около 10 ГГц), что объясняется особенностями множителей $(1+i\omega\tau)^{-1} = (1-i\omega\tau)/(1+\omega^2\tau^2)$: реактивная проводимость, в отличие от активной, пропорциональна первой степени ω . В слабом поле она имеет индуктивный характер, но в области ОДП меняет знак вместе с активной составляющей и становится емкостной. В дальнейшем на очень высоких частотах за время периода поля межзонные переходы не успевают происходить (высокочастотная составляющая заселенности долин уменьшается), и реактивная проводимость снова становится индуктивной. Если учесть, что при этом большая часть электронов находится в верхних долинах, то величина проводимости определяется параметрами этих долин.

Учет тока смещения $j_{cm} = i\omega\epsilon_0\mathbf{E}$ приводит к появлению в комплексной проводимости σ_ω только мнимой составляющей $i\omega\epsilon_0$, а для нормированной величины σ_ω/σ ее вклад равен $\Delta\sigma_\omega/\sigma = i\omega\epsilon_0/e\eta\mu = i\omega\tau_{mkc}$. Здесь $\tau_{mkc} = \epsilon\epsilon_0/\sigma$ — максвеллово время релаксации, которое и определяет инерционность процессов, связанных с токами смещения. Его величина может изменяться в широких пределах в зависимости от концентрации примеси, но для типичных значений N_d порядка 10^{23} м^{-3} это время в сильных электрических полях составляет $10^{-1} \dots 10^{-2}$ пс. Соответственно влияние тока смещения заметно лишь на частотах в сотни гигагерц. Но уже при концентрациях примеси порядка 10^{21} м^{-3} максвеллово время релаксации становится большим, чем время релаксации энергии, и инерционность проводимости будет определяться, в основном, токами смещения.

Необходимо отметить, что рассчитанные релаксационные параметры GaAs хорошо описывают переходные процессы и в импульсных электрических полях.

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ

- Матуленис А., Пожела Ю., Реклайтис А. Динамика разогрева электронов / В кн.: Многодолинные полупроводники. Т. 1.— Вильнюс: Мокслас, 1978.
- Иващенко В. М., Митин В. В. Моделирование кинетических явлений в полупроводниках. Метод Монте-Карло.— Киев: Наукова думка, 1990.
- Куликов К. В., Москалюк В. А., Ханжиев Д. С. Насыщение дрейфовой скорости и упругость рассеяния // Электроника и связь.— 2001.— № 11.— С. 100—104.
- Москалюк В. А., Куликов К. В. Высокочастотная проводимость GaAs // Электроника и связь.— 2002.— № 17.— С. 40—43.